

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

## 龙芯中科技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	UG Fund、广发证券、富国基金
时间	2024年2月23日-27日
地点	北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼
上市公司接待人员	董事会秘书-李晓钰、证券事务代表-李琳
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司目前正从政策性市场向开放市场转型，提到要将自主化的优势转化为性价比优势和软件生态优势，请问公司在这过程中做了哪些工作？</b></p> <p>在把自主化的优势转化为性价比优势方面。（1）龙芯CPU坚持核心IP自主化，积累了上百种IP。（2）龙芯通过自主研发提高性能，比如LA664处理器核比上一代LA464处理器核性能大幅提高；龙芯最新通用处理器产品3A6000与Intel酷睿10代四核产品性能相当。（3）龙芯通过自主研发降低成本，3A6000硅面积比3A5000降低。</p> <p>在把自主化的优势转化为软件生态的优势方面。（1）夯实基础：完善LA架构的Linux平台。公司目前已建成与X86/ARM并列的顶层基础软件生态。龙架构得到了国际开源软件广泛认可与支持，可以基于LA架构的国际开源软件直接构建出完整的操作系统；得到了国内操作系统企业认可，国内主流操作系统都有基于LA的版本等。（2）广泛兼容：通过高效二进制翻译运行X86及</p>

ARM应用。在LA平台上运行X86/Windows和ARM/Android应用。（3）自主应用：发展自主应用生态。计划推出自主编程框架，发展自主应用。

## **2、服务器芯片的研发和市场情况**

我们最新的服务器芯片3C6000已经于去年年底交付流片，我们预计相比上一代产品3C5000通用处理器性能提高一倍，IO大幅提高，尤其是片间互联性能也提高很多，面积会比现在的5000系列小，成本还要再下降，我们评估6000系列服务器产品是具有开放市场竞争力的。

目前在售的服务器产品以3C5000为主，2023年在解决方案类的收入中包含一部分白牌服务产品。服务器业务增长比较快，但目前的体量还比较小，这部分业务属于公司的增量业务，现在用龙芯的芯片做服务器的整机厂家也有一些。

## **3、AI相关的工作公司是如何考虑的？**

龙芯目前主要做面向推理的AI芯片，形成CPU+GPGPU的最佳解决方案。龙芯第二代GPU核LG200将在2K3000中应用，支持图形加速、科学计算加速、AI加速。2K3000计划在今年上半年交付流片。在此基础上，后续将基于2K3000的GPGPU技术及3C6000的龙链技术，研制专用GPGPU芯片。目前LG200已完成结构设计和前期的物理设计评估，配套的驱动程序原型也已就绪，正在展开全面验证。